



钢泰公司 Indium Corporation

公司概况
Corporate Overview

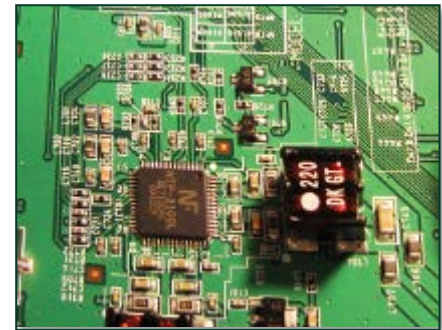
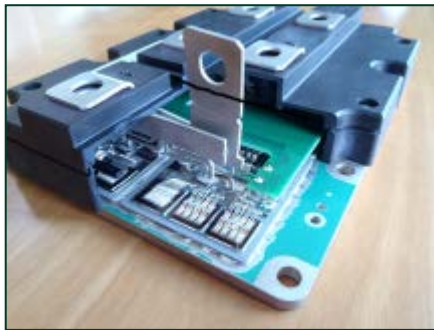
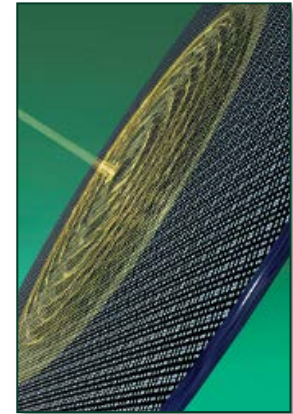
应用领域

Markets Served

钢泰公司为以下市场研发、制造和供应材料：

Indium Corporation develops, manufactures, and supplies materials for:

- 电子装配
Electronics assembly
- 半导体封装和组装
Semiconductor packaging and assembly
- 热管理
Thermal management
- 金属和化合物
Metals and compounds



覆盖行业

Verticals Served



汽车 Automotive



国防 Defense



钻井 Downhole



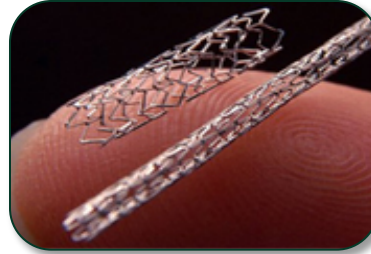
功率模块 Power Modules



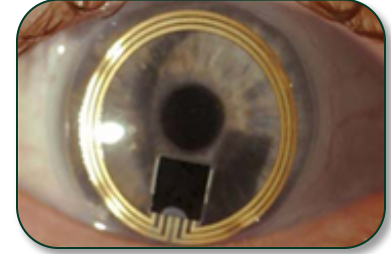
激光/光纤 Laser/Fiber Optic



LED



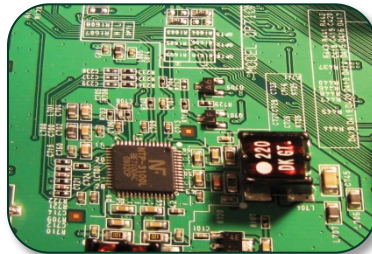
医疗 Medical



微机电系统 MEMs



金属提炼和回收
Metal Refining and Reclaim



PCBA



功率射频/微波
RF/Microwave

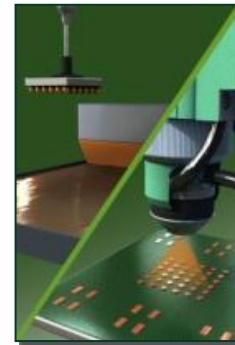
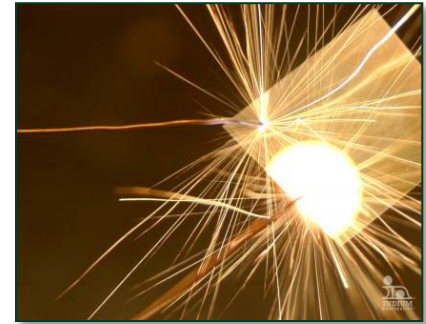


热导 Thermal

铟泰产品

Products

- 焊料（焊锡膏、焊锡粉、焊锡线、焊片等）
Solders (paste, powder, wire, preforms, etc.)
- 特种合金
Specialty alloys
- 助焊剂
Fluxes
- 铟、镓、锗等金属以及无机化合物
Indium, gallium, and germanium and inorganic compounds
- 溅射靶材
Sputtering targets & evaporation materials
- 纳米材料：NanoFoil®



我们的目标

Our Goal: Your Success

- 通过提供基于先进材料的优质设计、应用和服务，提高我们客户的生产力和利润。

Increase our customer's productivity and profits through premium design, application, and service of advanced materials.

- 我们成功的基石：

Our basis for success:

- 卓越的产品质量和性能
Excellent product quality and performance
- 专业的技术和客户服务
Technical and customer service
- 尖端材料的研发
Cutting-edge materials research and development
- 覆盖广泛的产品线
Extensive product range
- 最低的总体成本
Lowest cost of ownership

材料设计 and 应用史

History of Material Design and Application

- **1863** 铟元素(^{49}In)被发现
Elemental indium (^{49}In) discovered
- **1934** 铟泰公司成立
Indium Corporation founded
- **1940s** 镀铟工艺延长了飞机轴承的使用寿命
 ^{49}In plating process extends service life of aircraft bearings
- **1950s** 为Regency/德州仪器的晶体管收音机批量生产铟片
 ^{49}In preforms mass-produced for Regency/TI's transistor radio
- **1960s** 通过喷雾水解法, 氯化铟(InCl_3) 在玻璃表面形成透明导电膜 ;
此法被应用于生产飞机风挡、火车、冷冻柜等
 InCl_3 generates transparent conductive film on glass for air craft windshields, trains, and freezer cases via spray hydrolysis process

材料设计 and 应用史

History of Material Design and Application

- **1970s** 铟被用于III-V化合物半导体器件
⁴⁹In used in III-V compound semiconductor devices
- **1980s** 超细粉末和化学助焊剂促进了SMT（表面装贴技术）的发展
Fine powders and chemical fluxes enable SMT development
- **1990s** 先进的免洗焊锡膏和高分子材料为包括超细间距和阵列封装在内的快速微型化提供了便利
Advanced no-clean solder pastes and polymer materials support rapid miniaturization, including UFP and array packages
- **2000s** 独家无铅材料被用于大规模电子装配；太阳能材料研发和商业化
Unique Pb-free solder materials used in high-volume electronics assembly. Solar PV material development and commercialization

铟泰历史

History of Indium

铟泰公司成立

3月13日

1934

创立

铟泰公司（原美国铟泰公司）在美国纽约州Utica的805 Watson Place正式创立。总裁William S. Murray，副总裁J. Robert Dyer, Jr., Daniel Gray出任技术总监。

锢泰历史

History of Indium

独家无铅材料被用于大规模电子装配；太阳能材料
研发和商业化



创新

2002

锢泰公司因其NC-SMQ®230无铅焊锡膏的研发，
荣获Frost & Sullivan 产品创新奖。

钢泰历史

History of Indium

钢泰中国



9月15日
2003
苏州



钢泰公司于苏州设立中国公司。

4月19日
2006

深圳

钢泰公司在中国深圳开设销售处。2014年，深圳办公室搬迁新址，以满足增长和扩张需要。

我们的足迹遍布全球

Global Footprint



 KEY:

- Indium Facility Locations
- ◆ Indium Staff Locations

高品质认证

Manufacturing Excellence

- ISO 9001/2008
 - Utica, 美国纽约州
 - Clinton, 美国纽约州
 - Milton Keynes, 英国
 - 新加坡
Singapore
 - 芝加哥
Chicago
 - 苏州, 中国
Suzhou, PRC
- ISO 14001:2004
 - Milton Keynes, 英国
 - 新加坡
Singapore
- TS16949 (换新证审批中
R&D TS)
 - Milton Keynes, 英国
 - 新加坡
Singapore



钢泰数据

Indium Corporation: By the Numbers

- 82年历史的老牌企业，82年持续健康增长
82 years of private ownership and consistent growth
- 800+ 员工
800+ employees
- 9家工厂
9 factories
- 5国设有生产基地
5 countries of manufacturing
- 高盈余质量
High quality earnings
- 低负债
Low debt position
- 美国境外收入 > 60%
>60% of revenue outside the USA

公司架构

Corporate Structure

- 金属及化合物

Metals and Compounds

- 铟、镓、锗、锡等金属
(包括超高纯度如6N和7N的铟和镓) 和无机化合物

Indium, germanium, gallium, and tin metals including high-purity (6 & 7N indium and gallium) and inorganic compounds

- 焊料和能源材料

Solder and Energy

- PCB组装焊料

PCB assembly solder materials

- 工程焊料

Engineered solder materials

- 半导体和先进材料

Semiconductor and advanced materials

- 导热界面材料

Thermal interface materials

- 纳米科技

Nanotechnology

- 薄膜和太阳能组装材料

Thin-film and solar assembly materials

领先科技

Technology Leadership

- 锢泰公司致力于在技术发展上与各重要市场的战略合作伙伴保持一致

Indium Corporation strives to align its technology roadmap with our strategic partners in each of our critical markets.

- 18位博士全身心投入焊接材料的研发

18 PhDs actively researching joining and bonding materials

- 李宁成博士的畅销书：《回流焊接工艺及故障排除》
Dr. Lee's Popular Book: *Reflow Soldering Processes and Troubleshooting*
- Lasky博士的畅销书《光纤信息传输指南》
Dr. Lasky's Popular Book: *Handbook of Fiber Optic Data Communication*

- 我们的产品立足于今天，服务于未来

We deliver products today for tomorrow's technology.

公司荣誉

Recognition

客户表彰

Customer Awards

- 英特尔 Intel
 - Preferred Quality Supplier Award
 - Quality Operating System Award
- 天弘 Celestica
 - Total Cost of Ownership Award
- 信华精机 Shinwa
 - Best Supplier Awards
- 三星 Samsung
 - Superior Vendor Award

领导力奖

Leadership Awards

- Frost and Sullivan (4次)
- 年度企业
Business of the Year

获奖产品

Awarded Products

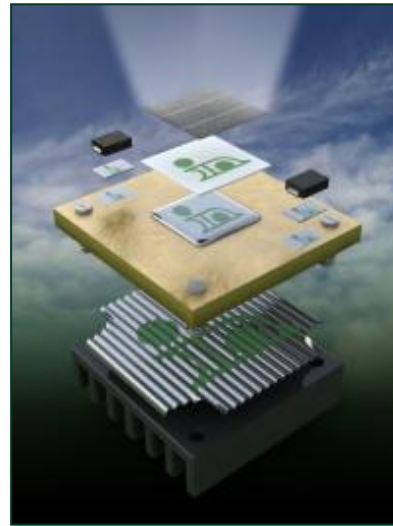
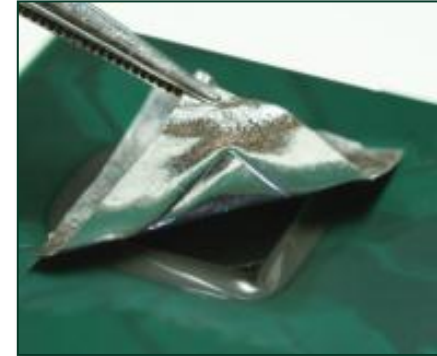
- Indium8.9
- SACm®
- BiAgX®
- InFORMS®



焊接材料

Solder Materials

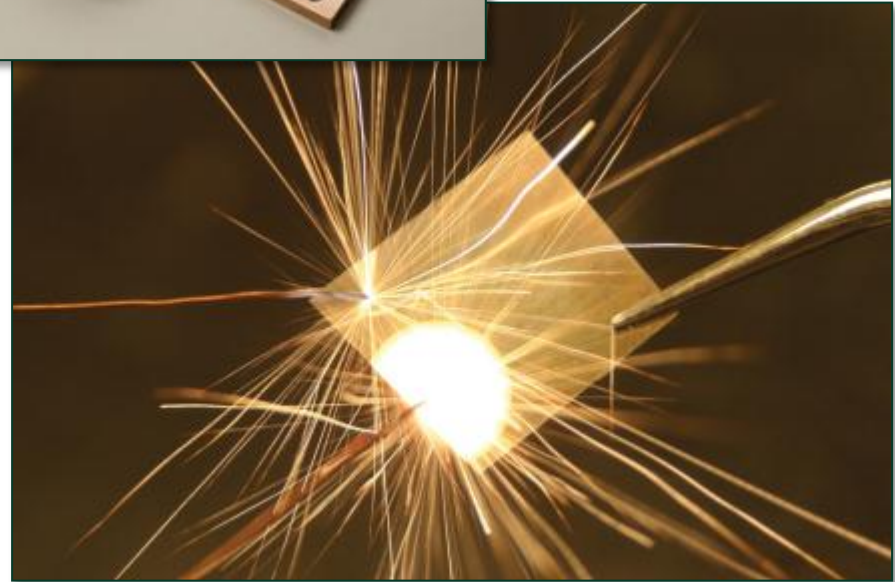
- PCB 组装
PCB assembly
- 半导体封装
Semiconductor packaging
- 功率半导体
Power semiconductors
- 工程焊料
Engineered solders
- 热管理
Thermal management



纳米科技

Nanotechnology

- NanoFoil®
- NanoBond®
- 靶材绑定
Target bonding
- 元件镶嵌
Component mounting
- 能源材料
Energetics



金属及化合物

Metals and Compounds

- 平板显示器
Flat panel displays
- 化合物半导体
Compound semiconductor
- 光纤
Fiber optics
- 低熔点合金
Low melting point alloys
- 储能材料
Energy storage
- 色料及着色剂 (抗高温)
Pigments and colorants



谢谢！
Thank you!